

GLANZOX

Материал для полирования кремния



This photograph is an image.
На данной фотографии представлено изображение изделия.

GLANZOX

With the increasing integration of semiconductor devices and the larger size of wafers, a damage-, haze- and heavy metal contamination free, flat, as well as nanotopography mirror-like silicon surface is essential. Fujimi's GLANZOX series was developed to meet such requirement. GLANZOX polish consists of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients. This product results in an almost perfectly polished surface. In response to the recent demand for considerable reductions in the metal impurities that affect device characteristics, higher-grades of polish containing ultra-pure colloidal silica have been developed.

GLANZOX

С ростом использования полупроводниковых устройств и увеличением размеров полупроводниковых пластин все важнее становится получение ровной, зеркальной поверхности кремниевого материала с хорошими нанотопографическими свойствами, без повреждений, без помутнений, без загрязнения тяжелыми металлами. Серия полировальных материалов GLANZOX от Fujimi позволяет удовлетворить эту потребность. Полировальный материал GLANZOX представляет собой суспензию из коллоидальной двуокиси кремния в жидкости, составленной из особых ингредиентов. Данное изделие позволяет получить практически совершенную поверхность. В ответ на недавнее требование значительно снизить содержание металлических примесей, которые влияют на характеристики устройств, были созданы полировальные материалы более высокого класса, содержащие сверхчистую коллоидальную двуокись кремния.

Typical Physical Properties of GLANZOX

Типовые физические свойства GLANZOX

Item Поз.	Type Тип	1103	1302	1304	3500
Main component Основной ингредиент		Ultra-pure SiO ₂ (colloidal) Сверхчистый SiO ₂ (коллоидальный)	pure SiO ₂ (colloidal) Чистый SiO ₂ (коллоидальный)	pure SiO ₂ (colloidal) Чистый SiO ₂ (коллоидальный)	
Content of SiO ₂ (%) Содержание SiO ₂ (%)		17,5	18,5	18,5	—
PH		11,4	11,4	11,4	10,1
Specific gravity Относительная плотность		1,1	1,1	1,1	1,0
Average particle size (nm) Средний размер зерна (нм)		35	35	9	—
Application Применение		For First polishing Для черновой полировки	For First polishing Для черновой полировки	For First polishing Для черновой полировки	—
Standard Net weight Стандартная масса нетто		17 kg 17 кг	10 kg 10 кг	10 kg 10 кг	10 kg 10 кг
Drum Бочка		220 kg 220 кг	220 kg 220 кг	220 kg 220 кг	200 kg 200 кг

Item Поз.	Type Тип	3900	3900RS	3101	3100M
Main component Основной ингредиент		Ultra-pure SiO ₂ (colloidal) Сверхчистый SiO ₂ (коллоидальный)	pure SiO ₂ (colloidal) Чистый SiO ₂ (коллоидальный)	pure SiO ₂ (colloidal) Чистый SiO ₂ (коллоидальный)	pure SiO ₂ (colloidal) Чистый SiO ₂ (коллоидальный)
Type of product Тип материала		9,1	9,1	4,5	9,1
PH		10,5	10,5	10,6	10,3
Specific gravity Относительная плотность		1,05	1,05	1,03	1,05
Average particle size (nm) Средний размер зерна (нм)		35	35	35	35
Application Применение		Final For Final polishing Чистовая для чистовой полировки	Final For Final polishing Чистовая для чистовой полировки	Final For Final polishing Чистовая для чистовой полировки	Final For Final polishing Чистовая для чистовой полировки
Standard Net weight Стандартная масса нетто		10 kg, 20 kg 10 кг, 20 кг	10 kg 10 кг	10 kg 10 кг	10 kg 10 кг
Drum Бочка		200 kg 200 кг	200 kg 200 кг	200 kg 200 кг	200 kg 200 кг



FUJIMI INCORPORATED

1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8502 Japan

TEL:(052)503-8112 FAX(052)503-7734

TEL.: (052) 503-8112 ФАКС: (052) 503-7734

1-1, Chiryō-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8502 Япония

Серия GLANZOX E

Полирование кремниевых кромок

■ GLANZOX E-Series

With the increasing integration of semiconductor devices, wafer surfaces must be cleaned more efficiently than ever. To prevent dusting due to transportation and handling, and reinforcement of the edge surface, mirror-finishing of the edge surface must be performed during the wafer manufacturing process. GLANZOX E-Series high-efficiency polish was developed exclusively for mirror finishing of wafer edge surfaces. It is comprised of colloidal silica dispersed in a liquid composed of special ingredients, and is superior in terms of cleanability after polishing.

■ Серия GLANZOX E

С ростом использования полупроводниковых устройств повышаются требования к чистоте поверхностей полупроводниковых пластин. Для предотвращения загрязнения пылью во время перевозки и других работ, а также для укрепления поверхностей кромок технологический процесс изготовления полупроводниковых пластин включает в себя зеркальное полирование поверхностей кромок. Полировальные материалы GLANZOX серии E предназначены специально для зеркальной полировки кромок полупроводниковых пластин. Эти материалы представляют собой коллоидальную двуокись кремния, диспергированную в специальной жидкости, и обеспечивают превосходную очищаемость после полировки.

Typical Physical Properties of GLANZOX E-Series

Типовые физические свойства GLANZOX серии E

Item Поз.	Type Тип	E301	E303	E304
Main component Основной ингредиент		SiO ₂ (colloidal) SiO ₂ (коллоидальный)	pure SiO ₂ (colloidal) Чистый SiO ₂ (коллоидальный)	pure SiO ₂ (colloidal) Чистый SiO ₂ (коллоидальный)
Content of SiO ₂ (%) Содержание SiO ₂ (%)		35	35	40
PH		11,5	10,6	11,6
Specific gravity Относительная плотность		1,24	1,24	1,28
Average particle size (nm) Средний размер зерна (нм)		55	55	35
Kind of water Вид полупроводниковой пластины		bare silicon & oxide кремний с открытой поверхностью и оксид	bare silicon & oxide кремний с открытой поверхностью и оксид	bare silicon кремний с открытой поверхностью
Standard Net weight Стандартная масса нетто		18 kg 18 кг	20 kg 20 кг	18 kg, 20 kg 18 кг, 20 кг
Drum Бочка		240 kg 240 кг	240 kg 240 кг	240 kg 240 кг